

# Indholdsfortegnelse

---

0.1	felt . . . . .	2
<b>Kapitel 1</b>	<b>gitter</b>	<b>5</b>



Det thermodynamiske system vi har valgt at skrive om til den skrevne projekt i thermodynamik er i overordnede træk luft drevne processor-kølere. Da forfatterne personligt interesserer sig for opbygning af PC, herunder køling som er en meget vigtig faktor. Herunder kølere brugt i såvel kerne processorerne(CPU) som de grafiske processorer(GPU). For en god ordens skyld, har vi valgt at sige at systemgrænserne går imellem processoren og det køletekniske system, således at processoren og dets interface med det køletekniske system er adskilt fra det termodynamiske system. Processorerne kommer da til at definere energistrømmene ud af systemet og den varme der skal ud af systemet.

Lauritzens og Eriksen, Termodynamik danner grundlagt for beregninger i skrivelsen der følger samt tabel opslag for diverse værdier.

## 0.1 D

der er 4 forskellige slags kølinger der vil blive undersøgt i denne rapport:

- kølegitre(Heatsink)
- Varmerør(heatpipes)
- blæser/fluid(el. andet flow)
- og fasekølinger

der er et overraskende stort udvalg af kølesystemer til processorer, og alt for mange til at de alle kan blive nævnt eller behandlet udtømmende i denne rapport. Men fælles for dem alle, er at de på en eller anden vis har fysisk forbindelse til processoren. I denne rapport, vil vi undersøge og sammenligne effekten af de forskellige kølesystemer, når varmen afledes til sidsti kølesystemet. Vi vil ikke forholde os til køling og luftgennemstrømning af det kabinet som processor og kølesystem befinder sig i. Ikke fordi, der ikke sker termodynamiske ting i det, men fordi det umiddelbart, uden dybdegående inspektion, mere drejer sig om bortledning af opvarmet luft end om bortledning af varme og måske ikke et direkte termodynamisk emne.

Fælles for alle PC kølesystemerne i denne rapport er den første komponent der leder varmen væk fra processoren.

Kølesystemet for en computerprocessor i første indsats består af en varmeledning af varme fra processor til kølesystem. Ofte faciliteres varmetransmissionen ved hjælp af en pasta, for at maximere kontaktflade til kølesystemet og for at modvirke galvanisk tæring. I kildelisten er to eksempler på en pasta, med konduktivitets værdier på 0,8 og 12,5 W/m\*K. imidlertid er intentionen med kølepasta, at optimere overflade kontakten imellem kølegitter og processor og ikke skabe et separat lag, hvor der kan dannes ekstra varme modstand. Så laget af kølepasta vil her blive negligeret. På en moderne processor med millioner af transistorer, er det set at processoren kan smelte ved store belastninger.

Så kort sagt, er det system vi undersøger et system der er afgrænset af interfacet til processoren og af bortledning af varme fra det sidste komponent af kølesystemet.

varmestrømmen fra processor til kølegitterets lameller kan beskrives som en varmeledning fra processor, over kølepasta til kølegitter. kølepastaen vil dog her blive fraregnet, idet kølepastaens fineste formål er at maximere overfalde kontakt imellem kølesystem og processor, og undgå luftlommer, der kan lede til overophedet luft. idet processoren består af silicone bruges silicones varmekonduktivitet på 149 . aluminim i kølegitteret på 229. Kølepastaen ses bort fra.

Tykkelserne på godset i den retning varme udbredes i er 4 mm for kølegitteret og regnes som en eneste massiv væg, idet processoren regnes for at have en ens temperatur i hele sin tykkelse. Varmen forsimples til at udbredes i en retning. Med disse antagelser kan varmemstrømmen igennem aluminiumem

# gitter 1

---

Fælles for alle 3 systemer er kølegitteret af aluminium, der er i kontakt med processoren. I simple systemer udgør den den eneste part i kølesystemet og kan selvfølgelig bestå af andre materialer end Aluminium. Men i rapporten her vil der blive brugt aluminum som grundlag.

Kølegitteret udnytter overflade areal til at bortlede varme ved konvektion fra et fast materiale(aluminium) til et fluid(atmosfærisk luft) .

En hyppig forekommende struktur i et køle gitter er ribbe, der giver en tvungen strømning af den varme luft bort fra kølegitteret. Som stiger til vejrs, hvor den erstattes af køligere luft.

Tallene for ovenstående kølegitter er importeret fra en arbejdsfil i solidworks

Arealet  $A=93733.73 \text{ mm}^2$  Massen  $m=31,58\text{gr.}$  og varmekonduktiviteten for aluminium,  $\lambda_a l= 228 \frac{W}{m \cdot K}$

